

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次被担保对象郑州天璇新材料有限公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，2025 年 4 月 22 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向银行申请最高不超过 40,000.00 万元授信额度，公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 18,725.00 万元，在该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保；同时，天璇新材料作为河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”或“控股子公司”）的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 40,000.00 万元。上述担保事项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担保只计算一次。

上述担保事项的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止，担保额度在授权期限内可以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保期限以实际签订的担保协议为准。

准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

二、担保进展

近日，天璇新材料向中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称“中信银行”)申请 800.00 万元贷款额度并签署《国内信用证融资主协议》，同时，控股子公司河南天璇已与中信银行签订了《最高额保证合同》(以下简称“《保证合同》”)。控股子公司河南天璇将为该贷款事项提供全额担保，预计担保最高金额为 800.00 万元。上述合同的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

上述担保事项均在公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议和 2024 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交董事会或股东会审议。

本次担保前，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 37,432.00 万元，剩余可用担保额度为 20,000.00 万元；本次担保后，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 38,232.00 万元，剩余可用担保额度为 19,200.00 万元。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司

成立日期：2023 年 05 月 22 日

注册地址：郑州经济技术开发区花溪街 192 号郑州经开综合保税区 B 区 01-17 号

法定代表人：王峙强

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非

金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
河南天璇半导体科技有限责任公司	10,000.00	100.00%

与公司关系：河南天璇半导体科技有限责任公司为公司合并报表范围内控股子公司，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。

2、财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	83,440.84	88,778.37
负债总额	74,820.60	84,559.13
净资产	8,620.25	4,219.24
资产负债率	89.67%	95.25%
项目	2024年度	2025年1月-9月
营业收入	0.00	3,392.55
利润总额	-1,726.51	-5,933.63
净利润	-1,307.81	-4,401.00

注：上述 2024 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他事项：天璇新材料与郑州银行股份有限公司中原科技城支行于 2024 年 8 月 6 日申请的 25,000.00 万元贷款额度，与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行于 2025 年 8 月 27 日申请的 20,000.00 万元贷款额度，均以自有资产提供抵押担保；除此之外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

3、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

《保证合同》

债权人：中信银行股份有限公司郑州分行

保证人：河南天璇半导体科技有限责任公司

债务人：郑州天璇新材料有限公司

担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费

用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

担保金额：不超过 800.00 万元人民币

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年

是否提供反担保：否，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。

五、董事会意见

本次所涉及的担保事项在第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议及 2024 年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》的授权范围内。本次所涉及的担保有利于保证天璇新材料的项目建设及日常经营资金需求，天璇新材料为公司合并报表范围内的子公司，且为河南天璇的全资子公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

本次所涉及的担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 37,432.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 30.54%，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总余额为 38,232.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 31.20%。以上担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、最高额保证合同；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日